

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	景顺长城基金、南方基金、富国基金、东方基金、翻沐科技、兆天投资、青骊投资、红杉资本、泓德基金、国融基金、摩根士丹利基金、北京橡果、耕霖投资、深圳前海君安、北京硅谷先锋、亚洲掘金、平安证券、方正证券、国泰海通证券、恒泰证券、浙商证券、东方财富证券、华泰证券、天风证券、申银万国证券、招商证券、弘毅远方基金、西南证券、中金资本、集成电路与系统应用研究院
时间	2025年8月22日
地点	电话会
上市公司接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司管理层介绍 2025 年半年度经营情况 公司整体情况： 公司是国内半导体封装领域主力供应商，也是晶圆先进制程重要参与者。电镀液具备 Turn key 能力，覆盖 5-14nm 晶圆制造；先进封装光刻胶处于主力供应商地位，是唯一打破日本 JSR 垄断的国内供应

商。晶圆领域正性 PSPI 光刻胶首个国产化材料订单，具有国产化里程碑意义。

市场规模：根据中国电子材料行业协会统计数据，2025 年中国集成电路用电子化学品市场规模预计 86 亿，其中晶圆用 70 亿，封装用 16 亿。中国光刻胶市场中，晶圆制造用光刻胶市场规模预计 56 亿，封装用光刻胶预计 12.5 亿，OLED 用光刻胶预计 2 亿。整体来看，公司集成电路产品布局对应的电子化学品和光刻胶市场规模约 150 多亿。

经营业绩：2025 年上半年，公司实现营业收入 2.8 亿元，同比增长 50.64%；实现归母净利润 1,678.20 万元，同比增长 22.14%；归母扣非净利润 1,443.67 万元，同比增长 76.14%，其中电镀液及配套试剂收入 1.37 亿元，同比增长 64.32%；光刻胶及配套试剂收入 6,267 万元，同比增长 53.49%。主要受益于半导体行业持续向好，公司市场份额稳步提升。经营活动净现金流入 2285 万元，较 2024 年同期由负转正，主要因公司增加票据背书付款安排及销售商品收到的现金大幅增长。研发方面，2025 年上半年研发投入 3,041.99 万元，同比增长 44.50%，占营业收入的比例为 10.87%，公司研发人员增至 92 人，同比增长 37.31%，研发人员占员工总人数的比例为 38.66%，研发实力不断增强。

公司重点产品进展情况：在电镀液及配套试剂方面：公司在多领域有显著进展。传统封装领域，占约 30%市场份额，产品成熟且引领技术发展方向。先进封装领域，作为国内主力供应商，公司电镀铜、电镀锡银和化学镍钯金产品均已量产。产品可以覆盖 HBM 封装、2.5D/3D 集成封装、CoWoS 封装、混合键合（Hybrid Bonding）封装、玻璃基板封装等先进封装形式。晶圆制造领域，电镀液处于行业第一方阵：公司 28nm 铜制程清洗液、大马士革铜互联工艺镀铜添加剂已量产，5-14nm 先进制程的超高纯硫酸钴基液和添加剂在客户端测试且进展顺利，TSV 工艺高速镀铜添加剂配合设备厂商进行客户端 baseline 验证。PCB（HDI）与 IC 载板领域，PCB（HDI）电镀铜及 SLP 类载板电镀铜产品已量产，IC 载板应用领域的电镀铜产品仍在测试。

在光刻胶及配套试剂方面：在先进封装应用，公司先进封装用正胶和负胶已覆盖多家主流封装客户，市场份额持续提升。在未来的 2-3 年，公司

将进一步丰富产品型号，以实现全品类覆盖，不断巩固和扩大在该领域的市场份额，目标成为国内先进封装光刻胶和 PSPI 的主力供应商。目前公司负性光刻胶已成功拓展应用到玻璃基封装，获得头部客户量产订单。介电层/缓冲防护层应用负性 PSPI 和低温固化负性 PSPI 在客户端验证进展顺利。

晶圆制造应用，正性 PSPI 光刻胶目前小量产中，同步在多家晶圆客户验证；超高感度 PSPI（化学放大型）在主流晶圆客户可靠性验证阶段；晶圆 ICA 化学放大光刻胶在客户端验证测试顺利；公司高厚膜高深宽比 KrF 光刻胶目前处于实验室研发阶段。PERR 清洗液正在晶圆客户端验证中。

半导体显示应用，公司 OLED 高感度 PFAS Free 正性光刻胶，已顺利通过了头部面板客户的验证，并且正处于多家 OLED 显示客户端的同步验证阶段。

公司自研光刻胶树脂方面，公司具备光刻胶树脂的供应能力，形成了从树脂分子结构设计、合成、纯化、光刻胶配方开发到工艺验证的完整全链条研发和制造体系。

并购方面：东南亚子公司 INOFINE 并购整合完成，2025 年 1 月起开始并表。公司东南亚制造中心建设与运营筹备有序推进，目标实现主要产品本土化供应。

二、问答交流环节

问题一：请问公司产品有哪些突破的进展？未来哪些产品可以给公司带来增量？

答：公司在晶圆领域、先进封装领域、半导体显示以及 IC 载板领域产品均有所突破。在晶圆领域，28nm 制程的大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已经通过主流晶圆客户的认证，进入量产阶段。5-14nm 先进制程的超高纯硫酸钴基液和添加剂在客户端测试进展顺利。在先进封装领域，公司负性光刻胶已成功拓展应用到玻璃基封装，获得头部客户量产订单。公司 TSV 电镀添加剂及适用于 Bumping 与 RDL 工艺的电镀添加剂、TGV 工艺高速镀铜添加剂在客户端测试验证中。半导体显示领域，公司 OLED 阵列用高感度 PFAS Free 正性光刻胶，已顺利通过了头部面板客户的验证。

IC 载板领域，公司 Tenting 快速填孔电镀铜产品已成功导入头部 HDI 和 SLP 供应链，实现批量供货。公司 MSAP 用电镀配套试剂已在 IC 载板客户端实现批量供货。

问题二：TSV 与基础工艺相比，对公司产品需求的差异？

答：与基础封装工艺相比，TSV（硅通孔）工艺依赖高精度电镀铜填充通孔，需电镀液具备高均镀性、低空洞率特性，公司 TSV 电镀添加剂，可在深孔结构中实现快速、无空洞填充；随着 3D 堆叠存储芯片、CIS 传感器等 TSV 技术主导领域的发展，从而带动 TSV 电镀液的需求。

问题三：请问公司光刻胶树脂是自研吗？会对外销售吗？

答：公司自研光刻胶树脂，主要光刻胶用树脂由公司树脂研发团队开发，保证后续产品供应的自主可控和稳定性。公司自研光刻胶用树脂包括负性光刻胶的丙烯酸树脂，化学放大光刻胶和 KrF 光刻胶的聚对羟基苯乙烯树脂，PSPI 光刻胶的聚酰胺酯/聚酰胺酸/PBO 树脂，TSV 等特殊应用的化学放大光刻胶酚醛改性树脂等。公司具备光刻胶树脂的供应能力，形成了从树脂分子结构设计、合成、纯化、光刻胶配方开发到工艺验证的完整全链条研发和制造体系。

问题四：IC 载板市场规模和未来发展空间？

答：据 Yole Group 统计数据，2024 年，先进 IC 载板市场温和回升至 142 亿美元，同比增长 1%。受 AI 等应用带动，以及消费、汽车与国防等新兴领域的持续渗透，到 2030 年先进 IC 载板整体市场有望达到 310 亿美元。公司将电镀铜产品逐步推向 HDI、SLP、IC 载板应用领域，有效提高国产化率。IC 载板作为芯片与系统之间关键连接，其电镀工艺要求兼具高均匀性与精细图形能力，公司高均匀性电镀液专为载板电镀设计，可同时满足微孔填充与图形电镀的双重需求，提升产品一致性和良率。公司 MSAP 用电镀配套试剂已在 IC 载板客户端实现批量供货，MSAP 用 Pattern 填孔电镀铜产品目前正处于 IC 载板客户端测试阶段。

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025年8月25日